



2024-2025 年度我国电子信息产业 投融资情况分析

国家工业信息安全发展研究中心

2025 年 2 月

“工信安全智库”系列报告编委会

主任：蒋 艳

副主任：黄 鹏

成 员：李 强 冯 媛 殷利梅 杨志锋
 王花蕾 申 峻 刘 丹 孙倩文
 付 伟 胡思洋 王慧娴 闫 寒
 马瑞敏 王丁冉 王 蕊

编写组

撰 稿：王宏洁 王 蕊

审 稿：李 强 冯 媛 王花蕾 王慧娴

序

国家工业信息安全发展研究中心经过 60 余年的发展与积淀，在智库研究方面形成了丰硕的积累。2018 年 9 月，中心推出“工信安全智库”品牌，立足深化供给侧结构性改革和加快建设创新型国家战略需求，围绕制造强国和网络强国建设任务，聚焦网络安全、数字经济、软件产业、产融合作等重点领域，开展基础性、战略性、先导性智库研究，为工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等提供智力支持。

“工信安全智库”自 2019 年开始陆续推出“研判”“洞察”“瞭望”“指数”“案例”“编译”等系列研究报告，围绕党和政府决策急需的相关重大课题和关键问题，开展形势研判、专题调研、国际跟踪、景气测度、案例分析、报告翻译等方面的持续研究，为主管部门预见走势、把握机遇、应对挑战、谋划战略提供参考。

本次推出的《2024-2025 年度我国电子信息产业投融资情况分析》以风险投资、IPO、并购交易、新三板挂牌、市值监测等角度为切入点，阐述了 2024 年我国电子信息产业投融资总体情况，对 2025 年面临形势进行了分析研判，并提出了相关对策建议，旨在为电子信息产业高质量发展提供参考。

由于成稿仓促，加之水平有限，报告中难免有疏漏和错误之处，恳请批评指正。

编写组

2025 年 2 月

摘 要

电子信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业，是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础，是保障国防建设和国家信息安全的重要基石，是形成新质生产力的中坚力量，发挥着经济增长“倍增器”、发展方式“转换器”、产业升级“助推器”的重大作用。

2024 年，我国电子信息产业投融资市场呈现“头部集聚、结构分化、技术驱动”的特征。在生成式人工智能浪潮与半导体硬科技双引擎拉动下，我国电子信息领域以 30.4% 的投融资事件占比领跑全行业。全年共发生股权投资事件 518 起，同比下降 16.7%；投资规模 1599.97 亿元，虽同比下降 11.0%，但较 2022 年仍增长 1.3%，市场进入“量缩价稳”的新阶段。与此同时，美元资本退出、早期创新不足、区域发展失衡等问题凸显。在政策严把上市入口关，IPO 节奏阶段性收紧的情况下，2024 年 A 股共有 24 家电子信息企业成功上市，同比下降 57.14%；募资总额 183.65 亿元，同比下降 82.27%。并购重组与新三板挂牌成为资本退出的重要通道，2024 年我国电子信息领域全年共完成并购事件 563 起，同比小幅增长 1.62%；涉及交易总金额达 1019.49 亿元人民币，同比增长 10.02%。2022 年至 2024 年我国电子信息领域新三板新增挂牌企业数量年均复合增长率达 22.47%，通过新三板转板北交所上市的企业数量不断增加。

建议进一步优化资本供给结构，对关键核心技术领域早期“卡脖子”项目提供更大力度资本支持；进一步深化资本市场改革，拓宽多元化退出渠道，引导资金接续投入；进一步提升行业企业质量，引导资金向优质标的集中，实现估值与业绩的再平衡。

目 录

一、总体情况	1
(一) 股权投资情况	1
1. 资本市场下行压力缓和，电子信息产业融资规模领跑	1
2. 交易金额均值逐年上升，优质项目吸金能力不断增强	4
3. 早期项目数量占比下降，美元融资数量规模大幅缩水	9
(二) 资本退出情况	13
1. IPO 总量延续收缩态势，新股数量和募资规模均锐减	13
2. 并购交易市场逐步回暖，行业整合重组不断提质增速	17
3. 新三板挂牌量质共提升，助力化解一级市场退出僵局	21
(三) 股票市场情况	23
1. 电子信息指数筑底修复，四季度后市场迎来强劲反弹	23
2. 细分赛道表现分化显著，通信设备指数连续三年领涨	25
3. 上市企业超过七成盈利，半导体龙头个股市值超万亿	26
二、风险挑战	28
(一) 资本供给结构变化，早期创新活力受限	28
(二) 资本退出渠道收窄，压力传至募投环节	29
(三) 估值偏离历史中枢，泡沫存在碎裂风险	30
三、形势研判	30

(一) 技术周期与资本周期共创结构性机遇	30
(二) 产业政策与金融政策共促高质量发展	31
(三) 国产替代与出海机遇创造新增量需求	31
四、 对策建议	34
(一) 进一步优化资本供给结构，激活早期创新生态	34
(二) 进一步深化资本市场改革，引导资金接续投入	34
(三) 进一步提升行业企业质量，消化过高估值泡沫	35
参考文献	36

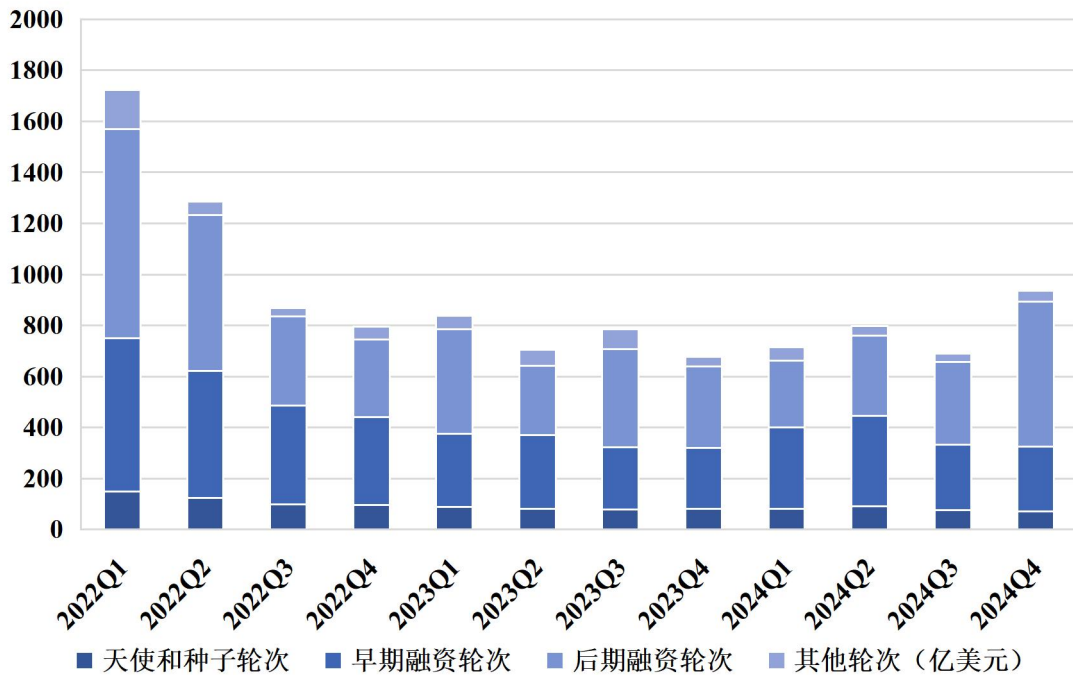
电子信息产业是国民经济的战略性、基础性、先导性产业。2024年，我国电子信息产业投融资市场呈现“头部集聚、结构分化、技术驱动”的特征。在生成式人工智能浪潮与半导体硬科技双引擎拉动下，我国电子信息领域以 30.4% 的投融资事件占比领跑全行业。全年共发生股权投资事件 518 起，同比下降 16.7%；投资规模 1599.97 亿元，虽同比下降 11.0%，但较 2022 年仍增长 1.3%，市场进入“量缩价稳”的新阶段。与此同时，美元资本退出、早期创新不足、区域发展失衡、资本退出通道不畅等问题凸显。

一、总体情况

（一）股权投资情况

1. 资本市场下行压力缓和，电子信息产业融资规模领跑

近年来，受全球经济增速放缓、国际市场需求低迷、地缘政治风险升级等多重不利因素影响，全球创业投资市场经历深度回调，进入 2024 年四季度后开始企稳回暖，确立“L 型”复苏拐点。Crunchbase 数据显示，全球创业投资季度投资总额从 2022 年一季度的 1727 亿美元持续下行至 2023 年四季度的 690 亿美元，累计降幅达 60.1%。2024 年，在生成式人工智能投资浪潮和半导体硬科技赛道双引擎拉动下，全球创业投资总额止跌回升至接近 3140 亿美元，增幅约为 3%（见图 1）。其中，有超过 1000 亿美元的资金流向了人工智能相关领域的公司，较 2023 年的 556 亿美元同比增长 80% 以上。值得关注的是，受益于美联储暂停加息周期带来的风险偏好修复及美股 IPO 退出渠道的改善，2024 年四季度全球后期项目融资额环比激增 74.7% 至 566 亿美元。

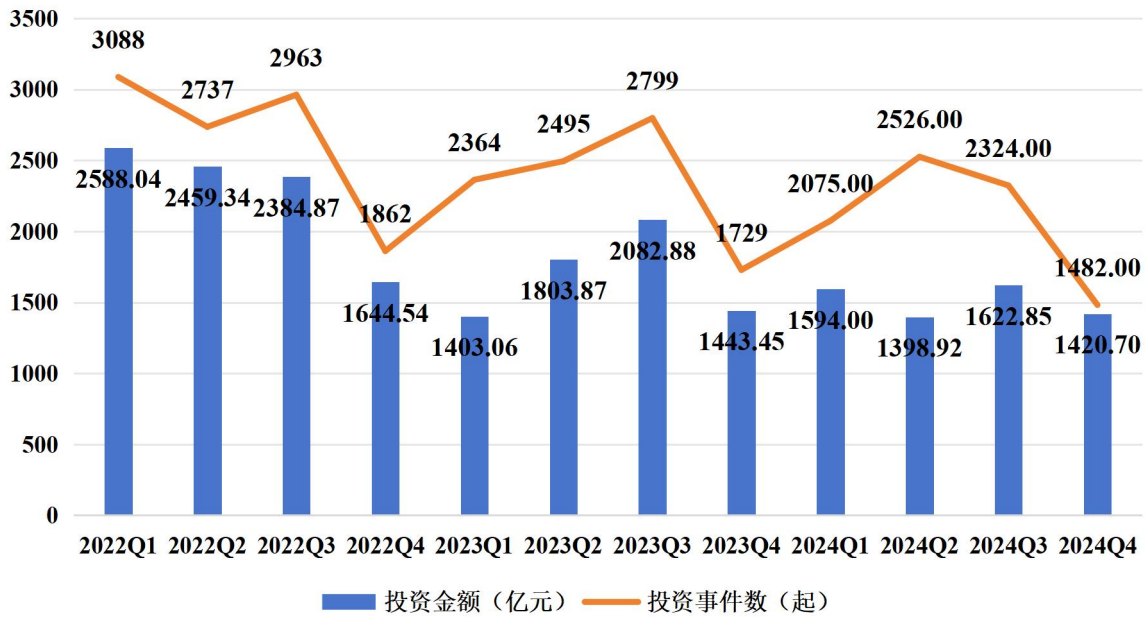


资料来源：Crunchbase，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025年2月）

图 1 2022 年至 2024 年全球创业投资市场情况

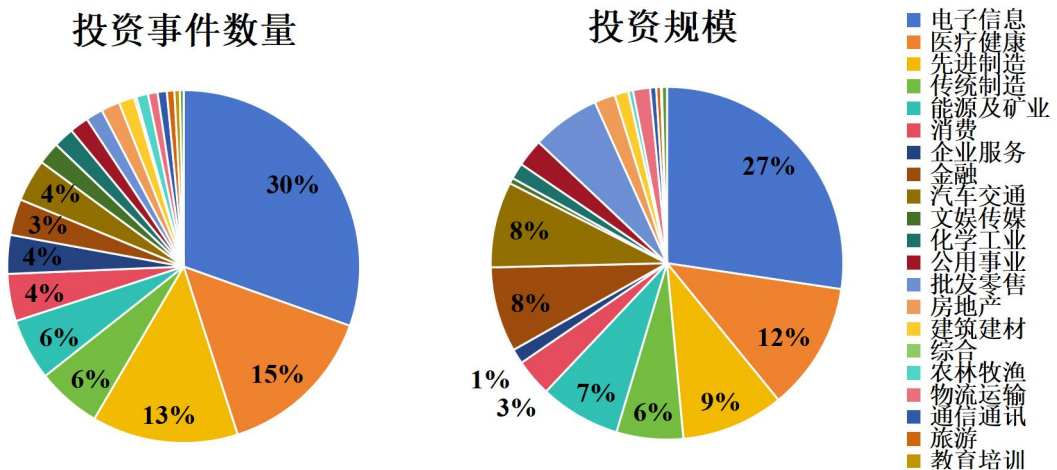
2024 年我国股权投资市场呈现波动调整态势，市场活跃度与资金规模均较 2023 年有所收缩。清科研究中心数据显示，2024 年我国股权投资市场共发生投资事件 8408 起，同比下降 10.4%；剔除偶发性极值案例后的投资总金额为 6036.47 亿元人民币，同比下降 10.3%（见图 2）。投资规模降幅与 2023 年的 25.8% 相比有所收窄，表明下行压力正不断缓和；单笔交易均值由 2024 年一季度的 0.77 亿元上升至四季度的 0.96 亿元，创近三年新高，反映出市场资金和资源正加速向头部项目集聚。其中，电子信息产业作为国民经济的战略性、基础性、先导性产业，始终是资本青睐的热门标的。根据投中研究院的统计数据，2024 年我国电子信息领域发生私募股权及风险投资

(PE/VC) 事件数量占全行业比重为 30.4%，对应投资规模比重为 27.4% (见图 3)，两项指标均为全行业之最，且投资规模占比与 2023 年相比进一步提高。



资料来源：清科研究中心，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 2 2022 年至 2024 年我国股权投资市场情况



资料来源：CVSource 投中数据，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 3 2024 年我国 PE/VC 市场各行业投资数量与规模占比

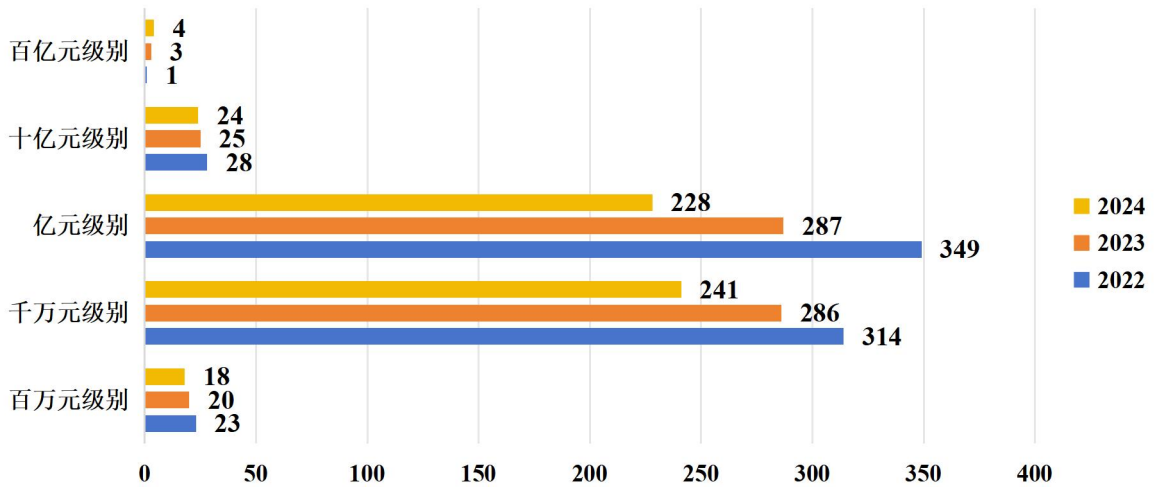
2. 交易金额均值逐年上升，优质项目吸金能力不断增强

近年来，我国电子信息领域股权投资事件数量呈收缩态势，而受到大额投资项目影响，投资规模在各季度间有剧烈起伏。据国家工业信息安全发展研究中心统计，2024 年我国电子信息领域共发生股权投资事件 518 起，同比下降 16.7%；投资规模 1599.97 亿元，虽同比下降 11.0%，但较 2022 年仍增长 1.3%，市场进入“量缩价稳”的新阶段（见图 4）。在宏观经济环境承压背景下，投资机构持续强化风险管控，投资策略由规模扩张转向战略聚焦。2022 年至 2024 年，我国电子信息领域股权投资市场单笔交易均值分别为 2.19、2.89 和 3.09 亿元，年复合增长率达 18.8%；亿元级及以上交易数量占比稳定维持在 50%左右，且该部分融资金额所占比重连年增加，三年分别为 95.6%、96.6%和 97.0%，头部项目虹吸效应持续增强（见图 5）。



资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 4 2022 年至 2024 年我国电子信息领域投融资情况



资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 5 2022 年至 2024 年我国电子信息领域投融资交易金额分布情况

2024 年我国电子信息领域共发生十亿元级别及以上的投融资事件 28 起（见表 1），合计金额超千亿元。从行业分布看，前十大融资事件均来自半导体行业，并以 21 起融资事件占据绝对主导地位，展现出资本市场对国家战略的强力支持。其中，最大一笔融资交易由北京市属国企北京电控集成电路制造有限责任公司于 2024 年 11 月获得，所获 199.9 亿元战略融资将用于投资建设总额 330 亿元的 12 英寸集成电路生产线项目。

表 1 2024 年我国电子信息领域十亿元级别及以上融资事件

（按融资金额排序）

序号	融资企业	交易日期	融资类型	总部地区	融资金额（亿）	细分领域	投资机构
1	北电集成	2024-11-16	战略融资	北京市	199.9	半导体	北京亦庄国际投资发展有限公司(亦庄国投),北京中发助力贰号股权投资基金(有限合伙)(中关村协同创新基金),天津京东方创新投资有限公司等

序号	融资企业	交易日期	融资类型	总部地区	融资金额(亿)	细分领域	投资机构
2	长电科技	2024-11-12	股权转让	无锡市 江阴市	116.91	半导体	磐石香港有限公司
3	长鑫科技	2024-03-29	股权融资	合肥市 巢湖市	108	半导体	工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(中国工商银行),中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)(中国建材基金),兆易创新,中银投资(中投公司),广州科集企业管理合伙企业(有限合伙),安徽和壮高新技术成果基金合伙企业(有限合伙)(方正和生)等
4	八亿时空	2024-03-28	股权转让	北京市 房山区	100.9	半导体	北京首钢基金有限公司(首钢基金),北京京西创业投资基金管理有限公司(京西创业)
5	皖芯集成	2024-09-26	战略融资	合肥市 瑶海区	95.5	半导体	晶合集成,工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(中国工商银行),建信金融资产投资有限公司(中国建设银行),农银金融投资(中投公司),交银金融资产投资有限公司(交银投资)
6	长鑫新桥	2024-09-06	战略融资	合肥市 包河区	82.2	半导体	合肥市产业投资控股(集团)有限公司(合肥产投集团)
7	紫光展锐	2024-06-03	E 轮	上海市 浦东新区	40	半导体	上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金合伙企业(有限合伙)(国泰君安),广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)(越秀产业基金),北京京国管股权投资基金(有限合伙)(北京国管),上海集成电路产业投资基金股份有限公司(上海国投),交银金融资产投资有限公司(交银投资)等
8	芯联先锋	2024-01-10	股权融资	绍兴市 越城区	38.5	半导体	绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(浙江产投),芯联集成

序号	融资企业	交易日期	融资类型	总部地区	融资金额(亿)	细分领域	投资机构
9	京隆科技	2024-05-14	并购	苏州市吴中区	36.56	半导体	通富微电,苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)(园丰资本),上海国资国企综改试验私募基金合伙企业(有限合伙)(中国国新基金),苏州欣睿股权投资合伙企业(有限合伙)(星云荣呈投资)
10	海力士无锡	2024-10-16	A 轮	无锡市新吴区	4.58	半导体	无锡产业
11	芯爱科技	2024-01-15	战略融资	南京市浦口区	25	半导体	北京融汇阳光润泽投资管理中心(有限合伙)(融汇资本),比亚迪,越秀产业基金,高远盛世资本
12	信息管线	2024-09-29	股权融资	上海市浦东新区	20.7	通信设备	中银投资(中投公司),建信金融资产投资有限公司(中国建设银行),宁波工融新动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)(中国工商银行),工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(中国工商银行)等
13	紫光展锐	2024-11-29	E+轮	上海市浦东新区	20	半导体	元禾璞华
14	时代光电	2024-12-13	股权融资	北京市海淀区	17.72	光学光电子	航天电子
15	海光信息	2024-05-18	股权转让	天津市滨海新区	17.58	半导体	诺德基金管理有限公司,南京盛泉恒元投资有限公司(盛泉恒元),财通基金管理有限公司(财通证券),J.P.MORGANSECURITIESPLC,深圳市康曼德资本管理有限公司(康曼德资本),上海金澹资产管理有限公司(金澹资产),广发基金管理有限公司(广发基金),民生证券股份有限公司(民生证券)等
16	士兰集科	2024-12-12	战略融资	厦门市海沧区	16	半导体	厦门半导体投资集团,士兰微

序号	融资企业	交易日期	融资类型	总部地区	融资金额(亿)	细分领域	投资机构
17	大唐半导体	2024-08-24	并购	北京市海淀区	15.92	半导体	大唐投资控股发展(上海)有限公司
18	良业环境技术	2024-04-19	战略融资	北京市	15	光学光电子	山东光视科技创新发展合伙企业(有限合伙),山东良创碧水股权投资基金合伙企业(有限合伙)(天然道控股),深圳建鑫天然环境基金企业(有限合伙)(天然道控股),山东建融中天股权投资基金合伙企业(有限合伙)(天然道控股)
19	信利仁寿	2024-04-03	股权转让	眉山市仁寿县	10.97	电子元器件	信利光电
20	创芯微	2024-10-23	并购	深圳市龙岗区	10.6	半导体	思瑞浦
21	芯崙半导体	2024-12-25	并购	上海市浦东新区	10.04	电子化学品	华海清科
22	大富科技	2024-09-25	股权转让	蚌埠市禹会区	10.01	通信设备	中国信达(信达资本),蚌埠市远大创新创业投资有限公司(远大创新创业)
23	熙泰科技	2024-02-07	A 轮	芜湖市弋江区	10	光学光电子	芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业(有限合伙)(瑞丞基金),芜湖市兴众风险投资有限公司(兴众风投),眉山天府新区产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)(眉山天投),四川制造业协同发展基金合伙企业(有限合伙)(四川兴川重点项目投资基金),坤言资本,芜湖市建设投资有限公司(芜湖建设投资)
24	星曜半导体	2024-06-27	B 轮	温州市龙湾区	10	半导体	温州湾新区产业投资平台,中移资本
25	芯驰科技	2024-07-12	C 轮	北京市	10	半导体	亦庄国投

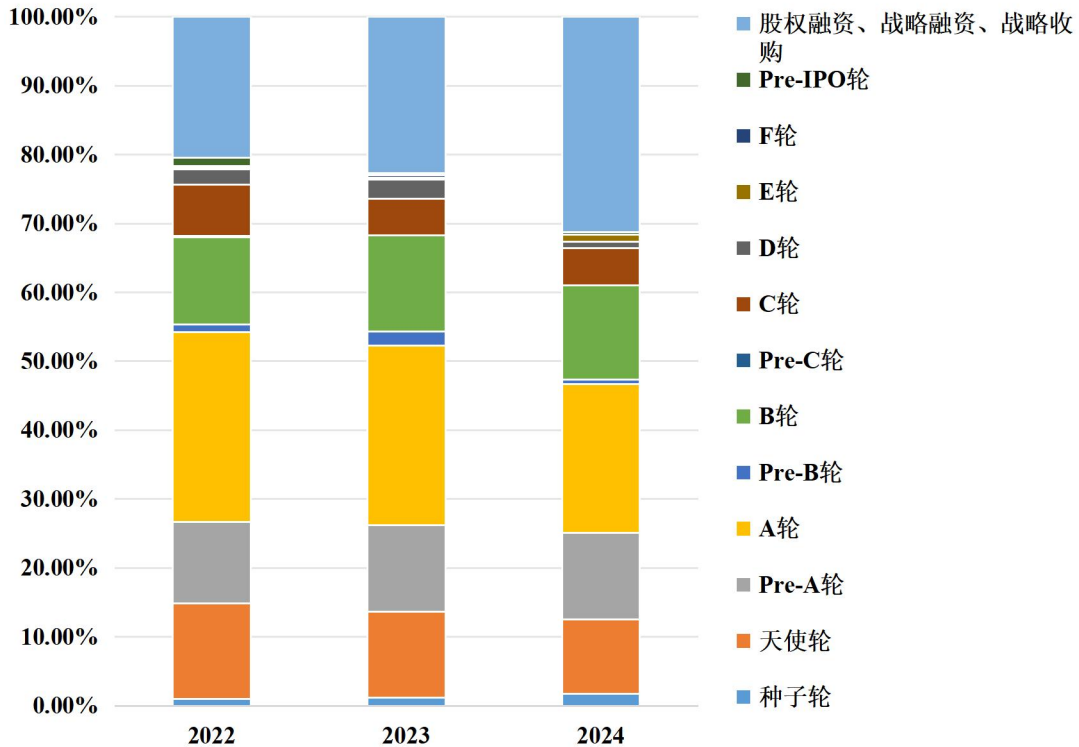
序号	融资企业	交易日期	融资类型	总部地区	融资金额(亿)	细分领域	投资机构
26	芯盟科技	2024-07-15	B++轮	嘉兴市 海宁市	10	半导体	湖北省科技投资集团有限公司(湖北科技投资),武汉光创新兴技术一期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(光谷产业投资),珠海市招赢共赢成长创业投资基金(有限合伙)(招银国际资本),合肥精确芯擎智能创业投资基金合伙企业(有限合伙)(精确资本),普华资本等
27	芯粤能半导体	2024-09-26	A轮	广州市 南沙区	10	半导体	广州南沙人工同智创业投资合伙企业(有限合伙)(南沙产投),广东省半导体及集成电路产业股权投资基金二期合伙企业(有限合伙)(粤财基金),社保基金湾区科技创新股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)(深创投),深圳市创新资本投资有限公司(深创投)等
28	麦歌恩微电子	2024-12-06	并购	上海市 长宁区	10	半导体	纳芯微,苏州纳星创业投资管理有限公司(苏州纳星创投)

资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025年2月）

3. 早期项目数量占比下降，美元融资数量规模大幅缩水

在融资阶段方面，受全球经济下行压力加剧影响，资本求稳避险情绪升温，部分投资机构和新募集创投基金的投资策略趋于保守，相较于早期、长期项目，更倾向于选择短期内可实现收益的成熟项目。据国家工业信息安全发展研究中心统计，除未公开融资轮次的事件外，2024年我国电子信息领域中早期投融资项目（B轮及B轮之前）数量占比为61.0%，与2023年相比下降超七个百分点（见图6）。在全部投资机构中，深创投（16项）、毅达资本（15项）、元禾控股（12项）、同创伟业（12项）、诺德基金管理有限公司（10

项)等机构投资的电子信息产业项目数量位居前五。

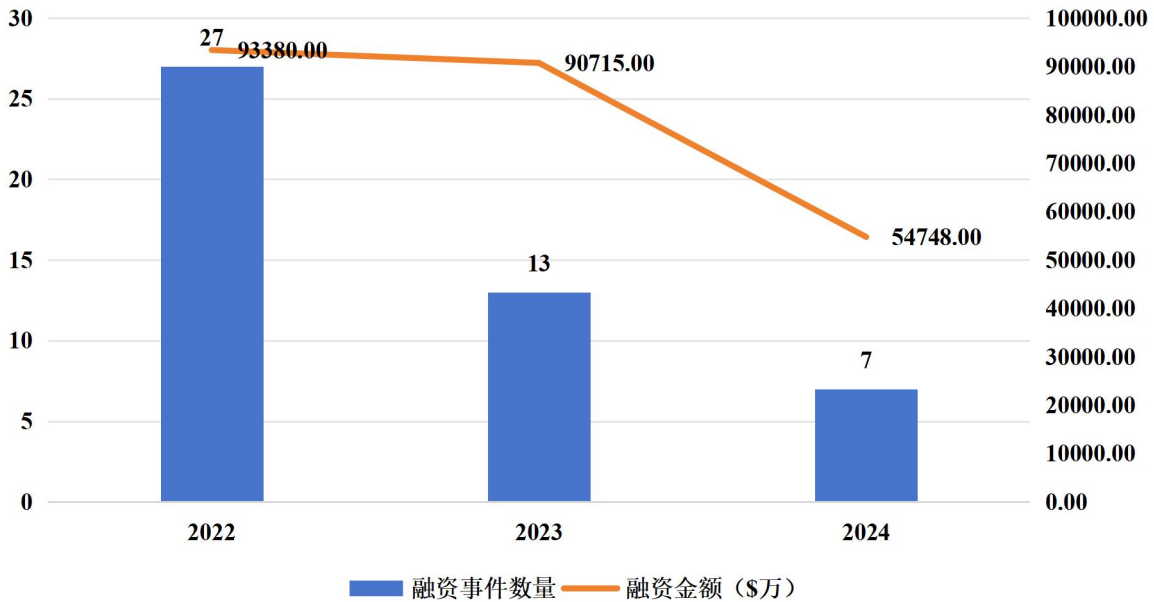


资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025年2月）

图 6 2022 年至 2024 年我国电子信息领域投融资事件轮次分布

在融资币种方面，近年来美国对华投资限制不断加剧，电子信息领域首当其冲，中国内地企业美元投融资数量与规模大幅缩水。2023年8月，美国总统拜登签署行政命令，禁止美国风险资本和私募股权公司对中国半导体和量子计算机、人工智能项目投资。在投资禁令压力下，红杉资本和纪源资本这两家中国最大的美国风险投资机构剥离了中国业务。全球领先的金融数据库 Dealogic 数据显示，2023年中国风险投资行业的外国资本投资同比下降约60%至37亿美元，仅为2021年最高值的10%。据国家工业信息安全发展研究中心统计，2024年我国电子信息领域仅有7起美元融资，与2022年

的 27 起相比大幅减少；总金额 54748 万美元，仅为 2022 年同期的 58.6%（见图 7）。

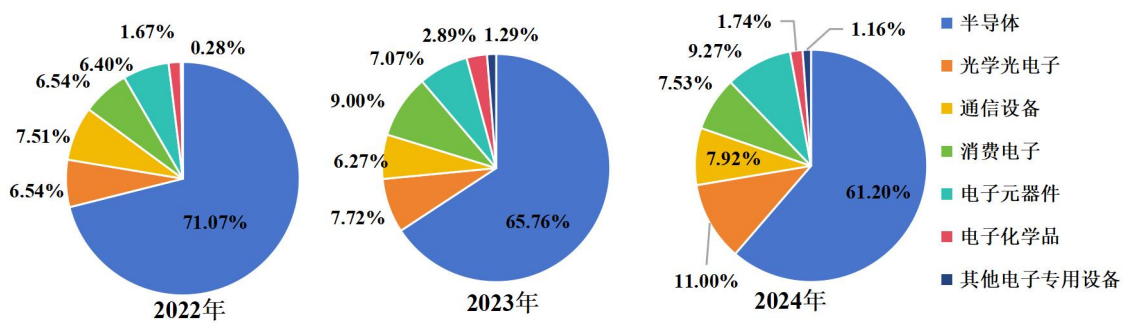


资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 7 2022 年至 2024 年我国电子信息领域美元投融资情况

在细分赛道方面，近年来我国电子信息领域各细分赛道的投融资热度分化显著，但总体结构较为稳定（见图 8）。其中，半导体领域的投融资热度最高、交易金额均值最大。2024 年我国半导体领域共有 302 家企业进行了 317 次融资，平均交易金额为 4.17 亿元，融资事件数量占电子信息领域总数超过 60%。具体而言，芯片设计领域的融资事件数量与融资金额最多，占比均超过 45%，其次分别是半导体设备、半导体材料、分立器件、集成电路制造、集成电路封测、集成电路设计等细分领域。光学光电子领域的投融资热度增长最快、产业集中度最高。随着 5G、物联网、人工智能技术的快

速发展，光学光电子产品的市场需求大幅提升，带动非上市投融资数量较大幅度增长。2024 年我国光学光电子领域共发生投融资事件 57 起，相比于 2023 年的 47 起增长超 20%。消费电子领域处于早期融资阶段的项目最多。2024 年我国消费电子领域处于早期融资阶段（种子轮、天使轮、A 轮）的项目占比高达 64.1%。

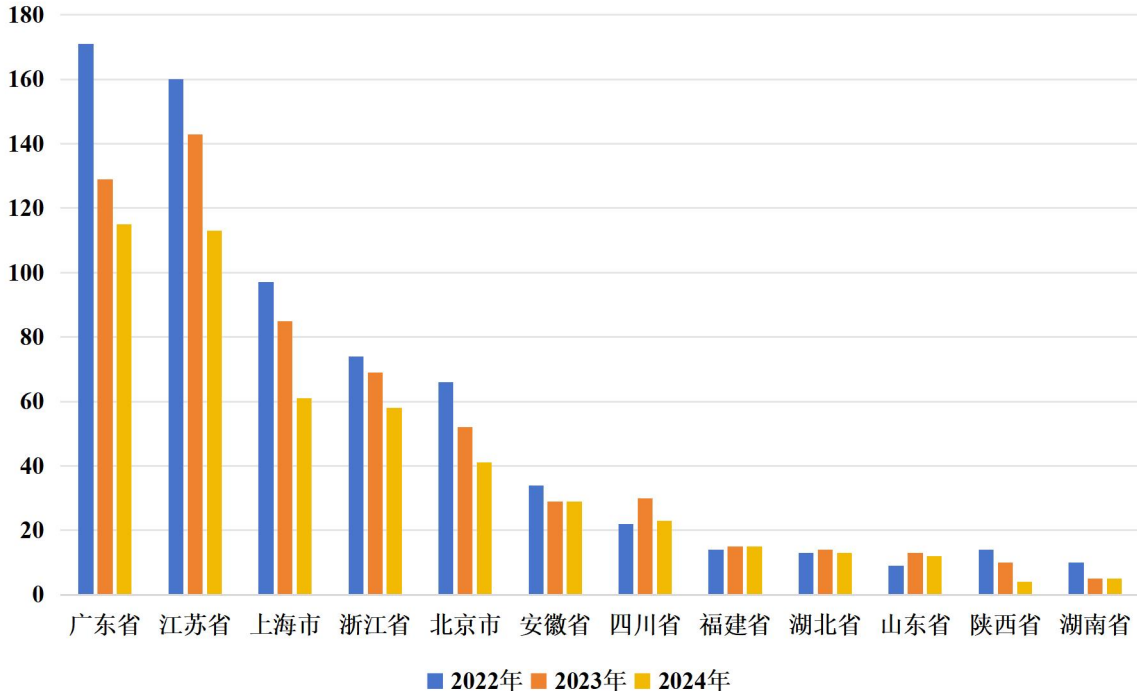


资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 8 2022 年至 2024 年电子信息领域细分赛道投融资数量占比

在区域分布方面，我国电子信息产业投融资呈现出了高度区域集聚性。据国家工业信息安全发展研究中心统计，2024 年广东（115）、江苏（113）、上海（61）、浙江（58）、北京（41）等地的电子信息企业获投资项目数量位列前五，五省市合计占比超 75%（见图 9），形成明显的“第一梯队”。其中，广东、江苏、浙江等地得益于成熟的电子信息产业链和密集的科技企业布局，对资本形成“虹吸效应”，凸显长三角与珠三角作为全国电子信息产业核心区的绝对优势。上海、北京作为全国两大经济中心，持续发挥资源、人才、政策、要素等方面的优势，在电子信息领域头部占有一席之地。此外，安徽（29）、四川（23）、福建（15）、湖北（13）位列“第二梯

队”，依托逐步构建区域性创新生态，成为资本关注的次级增长极。



资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025年2月）

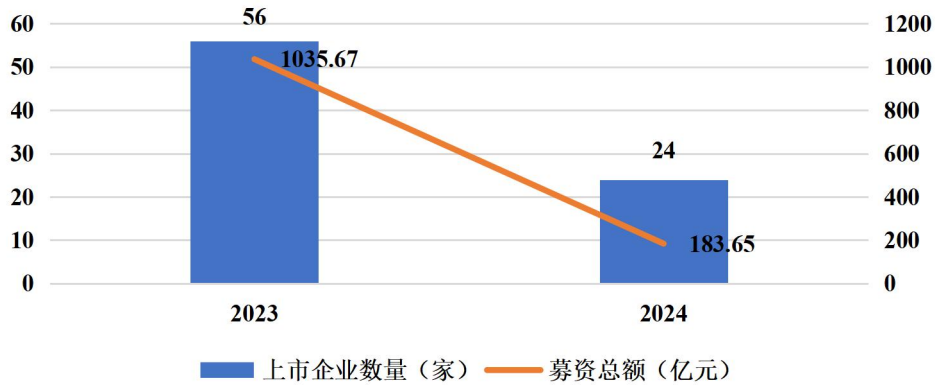
图 9 2022 年至 2024 年我国电子信息领域各省市获投资项目数量

（二）资本退出情况

1. IPO 总量延续收缩态势，新股数量和募资规模均锐减

2024 年我国延续上一年度对首发上市企业的强监管要求，出台了资本市场历史上第三个“国九条”，即《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出了更高的上市标准、更严格的上市辅导质量要求和更合规的上市公司环境。随着相关配套政策的相继落地，资本市场以强监管、防风险、提质量为主线，严把上市入口，力求从源头上实现上市公司质量提升。在此背景下，2024 年我国各行业 IPO 的总量呈现显著的收缩趋势。Wind 数据显

示,2024 年 A 股 IPO 数量为 100 家,比 2023 年的 313 家下降了 68.1%; 募资总额为 673.53 亿元,比 2023 年的 3565.39 亿元下降了 81.1%。2024 年 A 股终止 IPO 的企业数量达 430 家,远高于 2023 年的 245 家,创历史新高。具体到电子信息领域,2024 年 A 股共有 24 家电子信息企业成功上市,尽管数量较上年同比下降了 57.14%,但在 A 股全部行业中仍保持领先地位,占比达 24%; 募资总额 183.65 亿元,较上年同期下降 82.27%,占比达 27.27% (见图 10)。



资料来源：来觅，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 10 2023 至 2024 年我国电子信息领域首发上市情况

从区域分布来看,2024 年广东省以 9 家首发上市企业数量 (占比 37.5%) 与 56.23 亿元的募集资金总额 (占比 30.62%) 领跑全国电子信息产业 (见表 2), 政策支持与产业链协同效应突出。从细分领域来看,2024 年我国电子信息领域首发上市企业主要集中在半导体 (10 家)、电子元器件 (6 家)、光学光电子 (5 家)、消费电子 (2 家)、通信设备 (1 家) 等 5 个行业中。从上市板块来看,科创板凭借对“硬科技”企业的大力支持,成为我国半导体企业上市的首选板块,首发上市的 10 家半导体企业中,有 8 家选择在科创板上市;

创业板着力服务于优质成长性创新创业企业，成为我国电子元器件和光学光电子企业上市的首选板块；北证则更多服务于中小规模企业，首发上市企业平均募集资金规模仅为 2 亿元。

表 2 2024 年我国电子信息领域首发上市情况

序号	企业简称	总部地区	上市板块	上市日期	募资总额 (亿元)	细分领域
1	盛景微	江苏省	沪深主板	1 月 24 日	9.61	半导体
2	美信科技	广东省	创业板	1 月 24 日	4.05	电子元器件
3	成都华微	四川省	科创板	2 月 7 日	15.00	半导体
4	诺瓦星云	陕西省	创业板	2 月 8 日	16.29	光学光电子
5	上海合晶	上海市	科创板	2 月 8 日	15.00	半导体
6	龙旗科技	上海市	沪深主板	3 月 1 日	15.6	消费电子
7	戈碧迦	湖北省	北证	3 月 25 日	2.00	光学光电子
8	星辰科技	福建省	创业板	3 月 28 日	6.81	半导体
9	广合科技	广东省	沪深主板	4 月 2 日	7.37	电子元器件
10	灿芯半导体	上海市	科创板	4 月 11 日	5.96	半导体
11	欧莱新材	广东省	科创板	5 月 9 日	3.84	半导体
12	利安科技	浙江省	创业板	6 月 7 日	3.98	光学光电子
13	绿联科技	广东省	创业板	7 月 26 日	8.8	消费电子
14	龙图光罩	广东省	科创板	8 月 6 日	6.17	半导体
15	国科天成	北京市	创业板	8 月 21 日	5.00	光学光电子
16	成电光信	四川省	北证	8 月 29 日	0.92	通信设备
17	拉普拉斯	广东省	科创板	10 月 29 日	7.13	半导体
18	强达电路	广东省	创业板	10 月 31 日	5.31	电子元器件
19	万源通	江苏省	北证	11 月 19 日	3.46	电子元器件
20	壹连科技	广东省	创业板	11 月 22 日	11.92	电子元器件
21	联芸科技	浙江省	科创板	11 月 29 日	11.25	半导体
22	胜业电气	广东省	北证	11 月 29 日	1.64	电子元器件
23	佳驰科技	四川省	科创板	12 月 5 日	10.83	光学光电子
24	先锋精科	江苏省	科创板	12 月 12 日	5.71	半导体

资料来源：Wind、来觅，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

2024 年我国新股发行强化全流程严监管，资本市场严把准入关口，从源头提升了上市公司质量。在政策引导下，新发行股票质量

得以提高，破发现象得到显著改善。2024 年我国电子信息领域 24 只新发行股票中，仅上海合晶一只股票破发，其余股票均录得正收益，平均首日涨幅达 202.3%（见表 3），新股首日的强劲表现反映出市场对行业前景的乐观预期。其中，涨幅前三的企业分别为“先锋精科”（533.84%）、“胜业电气”（405.92%）和“强达电路”（387.93%），这些企业聚焦于半导体、电子元器件等细分领域，其技术壁垒与国产替代逻辑成为驱动股价上涨的核心因素。此外，高价发行的“诺瓦星云”（首发价 126.89 元）首日飙涨 202.62%，收盘价达 384 元，表明市场对高估值科技企业的接受度有所提升，其业务涉及 AI 芯片设计契合当前人工智能技术浪潮，凸显行业热点对股价的催化作用。

表 3 2024 年我国电子信息领域首发上市企业首日表现情况

序号	企业简称	首发价（元）	首日收盘价（元）	首日涨跌幅
1	盛景微	38.18	58.95	54.40%
2	美信科技	36.51	68.93	88.80%
3	成都华微	15.69	19.69	25.49%
4	诺瓦星云	126.89	384.00	202.62%
5	上海合晶	22.66	21.23	-6.31%
6	龙旗科技	26.00	51.92	99.69%
7	戈碧迦	10.00	22.71	127.10%
8	星辰科技	16.16	48.10	197.65%
9	广合科技	17.43	51.88	197.65%
10	灿芯股份	19.86	49.70	150.25%
11	欧莱新材	9.60	25.87	169.48%
12	利安科技	28.30	127.00	348.76%
13	绿联科技	21.21	45.55	114.76%
14	龙图光罩	18.50	34.90	88.65%
15	国科天成	11.14	35.65	220.02%
16	成电光信	10.00	20.10	101.00%
17	拉普拉斯	17.58	67.91	286.29%
18	强达电路	28.18	137.50	387.93%
19	万源通	11.16	52.88	373.84%

序号	企业简称	首发价（元）	首日收盘价（元）	首日涨跌幅
20	壹连科技	72.99	206.99	183.59%
21	联芸科技	11.25	50.98	353.16%
22	胜业电气	9.12	46.14	405.92%
23	佳驰科技	27.08	68.00	151.11%
24	先锋精科	11.29	71.56	533.84%

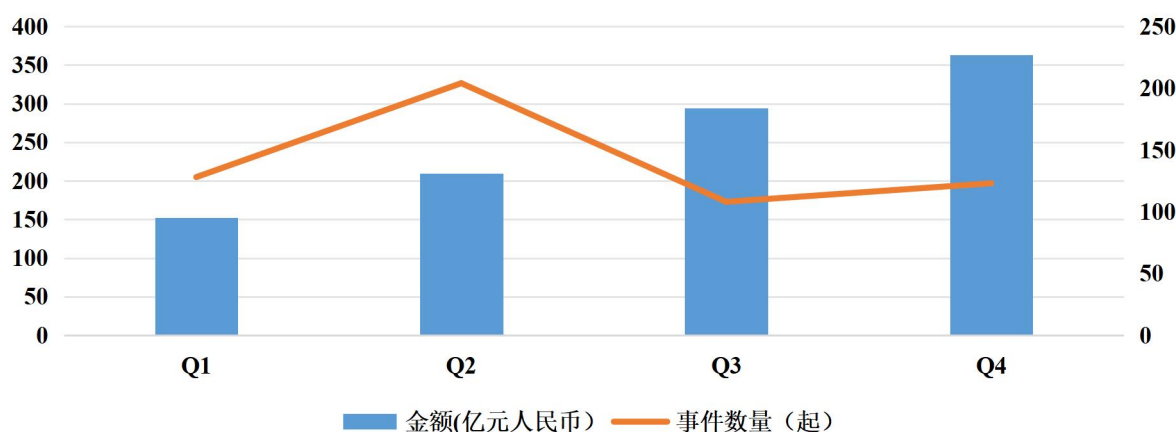
资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025年2月）

2. 并购交易市场逐步回暖，行业整合重组不断提质增速

2024年以来，我国相继出台一系列支持并购重组的政策措施，为并购市场的活跃发展提供重要支持。在国务院“国九条”核心政策指引下，6月、9月证监会分别发布“科创板八条”和“并购六条”，鼓励上市公司通过并购重组加强产业整合或向新质生产力方向转型升级，进一步推动并购重组市场高质量发展。12月，国务院国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，鼓励央企积极开展有利于提高投资价值的并购重组。在A股IPO阶段性收紧的情况下，企业上市融资与投资机构退出面临较大压力，并购重组成为资本退出的重要通道，四季度以来我国并购交易市场不断回暖。根据清科研究中心的统计数据，2024年我国企业参与的并购案例数总量为2335起，同比下降12.0%；涉及交易总金额超6000亿，同比下滑近四成。其中，第四季度并购案例数量共计563起，环比上升5.6%；交易规模达1829.10亿元，环比上升59.7%，政策效力逐步显现。

在此背景下，2024年我国电子信息领域并购市场呈现出“量稳质升”的活跃态势，全年共完成并购事件563起，同比小幅增长1.62%；

涉及交易总金额达 1019.49 亿元人民币，同比增长 10.02%。交易金额增速显著高于事件数量增速，表明单笔交易规模有所增长，行业整合不断加速。其中，第四季度交易金额占全年的 35.5%，反映出企业对 2025 年技术升级与市场扩张的提前布局。整体来看，并购交易以产业链上下游的资源优化整合为主，也包括大型企业在战略性新兴产业及海外市场的投资布局。



资料来源：wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 11 2024 年我国电子信息领域并购交易情况

在大额交易方面，2024 年我国电子信息领域共发生单笔交易金额超 10 亿元的大额并购事件 23 起（见表 4），主要集中在半导体（10 起）、通信设备（5 起）和消费电子（3 起）等细分领域，涉及总金额超 600 亿元人民币（含美元交易换算），交易事件数量与交易金额较 2023 年均有所增长，头部效应愈发显著。并购动因主要包含以下三方面：一是技术升级与产业链整合，如紫光股份通过全资子公司完成对新华三集团有限公司 30% 股份的收购，交易完成后，紫光股份持有的新华三股份比例由 51% 增加至 81%，将有利于紫光股份

进一步强化产业布局、发挥协同效应、提升核心竞争力。二是**资本优化与资产重组**，如合力泰科技股份有限公司和中通国脉通信股份有限公司等上市公司通过重整引入外部资金，使得公司的流动性压力得到缓解，资产负债结构得以优化，为后续经营提供了资金支持，退市风险警示有望撤销。三是**市场拓展与国际化布局**，如江波龙子公司收购 SMART Brazil 81%股权及 SMART Modular 81%股权，交易完成后，江波龙在海外的供应链能力将显著提升，海外存储业务得以进一步拓展，公司在全球存储器市场的竞争力将不断加强。

表 4 2024 年我国电子信息领域大额并购交易事件

(按交易金额排序)

交易时间	交易事件	交易标的	交易金额	涉及行业
9月5日	紫光股份子公司收购新华三30%股权	新华三30%股权	21.4亿美元	通信设备
11月14日	长电科技控制权变更	长电科技22.54%股权	116.91亿人民币	半导体
9月25日	长电科技子公司收购晟碟半导体80%股权	晟碟半导体80%股权	6.24亿美元	半导体
12月17日	世运电路25.90%股权权益变动	世运电路25.90%股权	33.94亿人民币	电子元器件
7月13日	天合光能5.0000%股权权益变动	天合光能5.0000%股权	22.75亿人民币	光学光电子
10月16日	大唐电信出售联芯科技100%股权,大唐半导体56.38%股权,成都信息80.00%股权,江苏安防30.82%股权,大唐节能20.00%股权,大唐智能卡14.37%股	联芯科技100%股权;大唐半导体56.38%股权;成都信息80.00%股权;江苏安防30.82%股权;大唐节能20.00%股权;大唐智能卡	22.13亿人民币	通信设备

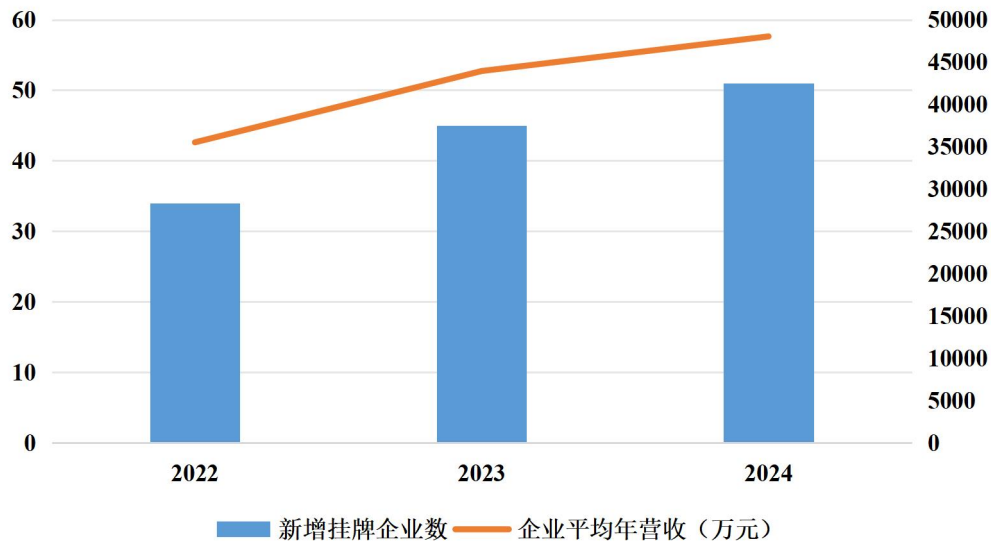
交易时间	交易事件	交易标的	交易金额	涉及行业
		14.37%股权		
3月26日	芯联集成增资芯联先锋获其部分股权	芯联先锋部分股权	22.1 亿人民币	半导体
12月31日	*ST 合泰重整	*ST 合泰部分股权	19.14 亿人民币	消费电子
5月18日	海光信息 1.20%股权询价转让	海光信息 1.20%股权	17.58 亿人民币	半导体
12月13日	士兰微子公司士兰集科增资扩股	士兰集科部分股权	16 亿人民币	半导体
4月22日	江波龙子公司收购 SMART Brazil81%股权及 SMART Modular81%股权	SMART Brazil81%股权; SMART Modular81%股权	2.05 亿美元	电子元器件
12月31日	*ST 通脉进行重整	*ST 通脉部分股权	14.46 亿人民币	通信设备
10月22日	深天马 A7.30%股权权益变动	深天马 A7.30%股权	13.79 亿人民币	光学光电子
5月14日	合众思壮子公司出售 Hemisphere GNSS100%股权	Hemisphere GNSS100%股权	1.75 亿美元	通信设备
2月1日	士兰微与其他方增资士兰明镓获其 31.58%股权	士兰明镓 31.58%股权	12 亿人民币	半导体
6月15日	澜起科技 2.2%股权权益变动	澜起科技 2.2%股权	11.64 亿人民币	半导体
11月6日	思瑞浦发债收购创芯微 100%股权	创芯微 100%股权	10.6 亿人民币	半导体
3月9日	胜利精密出售南京德乐 100%股权	南京德乐 100%股权	10.36 亿人民币	消费电子
4月25日	亨通光电子公司亨通高压引入新战略投资者	亨通高压 5.27%股权	10.3 亿人民币	通信设备
10月29日	捷捷微电定增收购捷捷南通科技 30.24%股权	捷捷南通科技 30.24%股权	10.16 亿人民币	半导体
5月24日	传音控股 1.00%股	传音控股	10.13 亿人民币	消费电子

交易时间	交易事件	交易标的	交易金额	涉及行业
	权询价转让	1.00%股权		
12月6日	纳芯微及子公司直接及间接收购麦歌恩 100%股权	麦歌恩 100%股权	10 亿人民币	半导体
3月30日	亨通光电子公司引入新战略投资者	亨通高压 5.41%股权	10 亿人民币	通信设备

资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

3. 新三板挂牌量质共提升，助力化解一级市场退出僵局

IPO 节奏阶段性收紧后，新三板因其相对较低的准入门槛和灵活的融资机制，成为优质企业股权融资退出的重要选择。近年来，新三板市场热度不断攀升，新增挂牌企业数量从 2022 年的 270 家增长至 2023 年的 326 家，再跃升至 2024 年的 350 家。其中，2024 年 9 月的新增挂牌企业数量达到了 68 家，刷新了近五年的月度新增挂牌企业数量纪录。具体到电子信息领域，据国家工业信息安全发展研究中心统计，从 2022 年至 2024 年我国电子信息领域新三板新增挂牌企业数量呈现稳步增长的趋势，分别为 34 家、45 家和 51 家，年均复合增长率约为 22.47%。这表明电子信息领域资本市场活跃度持续提升，越来越多的企业选择通过新三板挂牌来拓宽融资渠道、优化资本结构。与此同时，企业的平均年营收也显著增长，从 2022 年的 3.55 亿元增长至 2024 年的 4.80 亿元，反映出在技术进步、市场需求扩大以及政策支持等多重因素的推动下，电子信息行业整体规模的快速扩张以及企业盈利能力的显著增强。



资料来源：wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 12 2022 年至 2024 年我国电子信息领域新三板新增挂牌企业情况

2024 年我国电子信息领域 51 家新三板挂牌企业的营收规模差异显著，从 2744.96 万元至 29.30 亿元不等¹，总体上以中小型企业为主，超六成企业（32 家）营收低于 5 亿元，体现了新三板服务创新型中小企业的市场定位；企业净利润表现同样分化明显，但除紫光国芯外净利润均为正值，其中昂盛达、卓海科技、恒道科技、海菲曼、高特股份、杰理科技等企业的净利润率超 20%，反映出行业整体处于高景气周期；企业范围覆盖全国 12 个省级行政区，其中广东、江苏各以 13 家挂牌企业数量领跑全国，行业整体呈现出头部聚集、区域集中的特点。

除了帮助企业融资及实现资本退出外，新三板的转板上市机制还丰富了挂牌公司上市路径，打通了中小微企业成长壮大的上升通

¹ 营收及利润数据来源于企业 2023 年财报。

道，加强了多层次资本市场的有机联系。在沪深交易所 IPO 审核政策趋严的背景下，杰理科技、宸芯科技、科视光学、小鸟科技等企业已由原申报创业板/科创板 IPO 转为通过新三板挂牌路径，借助新三板转板机制向北交所递表，体现多层次资本市场衔接机制下的上市路径战略调整。

表 5 2024 年我国电子信息领域新三板新增挂牌企业（营收超 5 亿元）

（按总营收金额排序）

企业简称	挂牌日期	主办券商	总营收 (万元)	净利润 (万元)	总股本 (万股)	所属地区
杰理科技	2024-08-01	国泰君安	293055.44	62297.57	39995.50	广东省
华来科技	2024-01-24	国投证券	104489.15	8066.55	6000.00	天津
国容股份	2024-09-24	东方证券	95228.54	9669.03	14517.97	河南省
紫光国芯	2024-06-25	中信建投	91364.20	-19890.96	10613.51	陕西省
生力材料	2024-07-26	西部证券	83578.88	6019.40	10497.58	湖南省
拓普泰克	2024-07-24	广发证券	77207.43	7737.63	4623.59	广东省
卓英社	2024-03-25	广发证券	76486.08	4542.77	5434.93	山东省
沛城科技	2024-09-20	国泰君安	73288.51	9344.49	5000.00	广东省
紫江新材	2024-07-08	国投证券	71138.72	9023.65	5938.30	上海
银河电力	2024-12-30	广发证券	67774.38	10186.76	9905.00	广东省
尚研科技	2024-10-15	申万宏源	61553.94	4954.34	4800.00	广东省
科金明	2024-07-09	浙商证券	61434.72	4510.57	2752.75	广东省
衡东光	2024-09-03	招商证券	61336.44	6452.85	5782.15	广东省
冠优达	2024-08-02	东吴证券	60917.00	4318.90	8355.00	江苏省
安特磁材	2024-09-27	国信证券	59260.81	6965.12	6000.00	浙江省
华宇电子	2024-10-23	华创证券	57812.59	4202.05	6344.81	安徽省
世纪数码	2024-01-12	东方证券	57124.52	5134.46	3334.00	河南省
舟海智能	2024-09-09	东吴证券	55066.05	1283.81	1133.33	重庆
夏瑞科技	2024-08-16	中金公司	50733.89	3973.92	6000.00	广东省

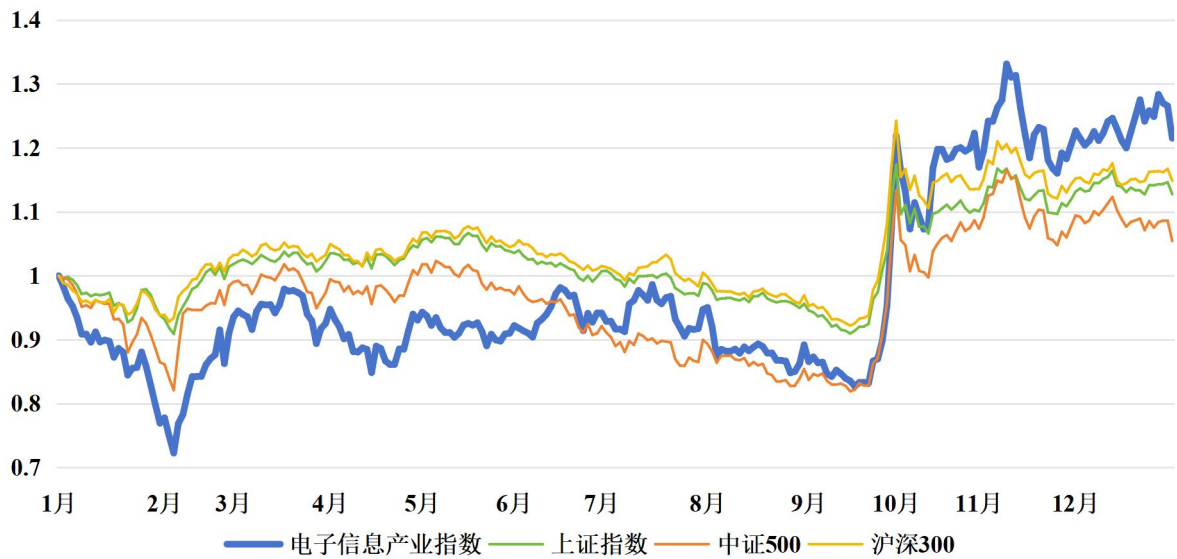
资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

（三）股票市场情况

1. 电子信息指数筑底修复，四季度后市场迎来强劲反弹

2024 年，受国际国内诸多复杂因素的叠加影响，投资者信心不足、悲观情绪较为严重，A 股市场缓慢寻底修复，于 9 月中旬迎来了阶段性的最低点。电子信息产业相对 A 股市场整体具有更大的波动率，指数震荡更为明显。国家工业信息安全发展研究中心电子信息产业指数²显示，自 1 月 2 日至 2 月 5 日，电子信息产业指数下跌 27.72%，大幅低于沪深 300 指数（期间累计跌幅为 6.59%）、上证指数（期间累计跌幅为 9.10%）和中证 500 指数（期间累计跌幅为 17.88%）（见图 13，以 2024 年首个交易日开盘价为基准对此后数据进行归一化）。随后增量资金入场救市，政策利好不断释放，电子信息产业指数快速反弹后进入横盘调整状态。9 月中下旬，随着美联储降息决议的落地，以及中国人民银行、金融监管总局、中国证监会一揽子增量政策的出台，A 股市场迎来了强劲反弹，其中电子信息产业指数 10 个交易日的反弹幅度接近 50%。进入四季度，在人工智能等新兴技术的推动下，电子信息产业迎来了新的市场需求爆发期，特别是在半导体设备国产化、汽车电子、智能终端等高成长性领域的投资热度大幅提升，投资者对这些领域的未来发展前景持乐观态度。2024 年年初至年末，电子信息产业指数累计上涨 21.51%，表现优于三大股指，沪深 300 指数（期间累计涨幅为 14.85%）、上证指数（期间累计涨幅为 12.75%）和中证 500 指数（期间累计涨幅为 5.42%）。

² 该指数将本报告范围内的 543 只电子信息个股以 2024 年 1 月 1 日为基期、1000 点为基点，按照自由流通市值加权法进行计算得出。

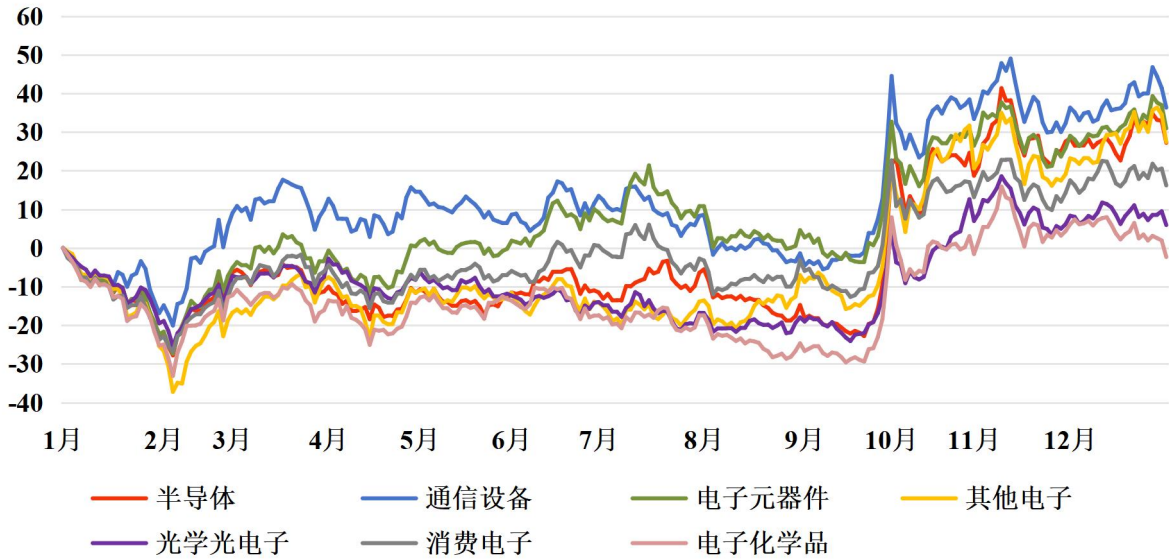


资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025年2月）

图 13 2024 年电子信息产业指数与三大指数走势

2. 细分赛道表现分化显著，通信设备指数连续三年领涨

2024 年我国电子信息领域各细分赛道指数分化较为显著（见图 14，以 2024 年首个交易日开盘价为基准）。受全球 5G/6G 部署、卫星通信技术突破等利好因素影响，通信设备指数在 2023 年 26.28% 涨幅的基础上继续以 36.32% 的增速领涨，已连续三年增速第一（见表 6）。电子元器件以 30.93% 的增速紧随其后，反映出电子信息产业链中上游零部件的需求旺盛。半导体指数在 AI 算力需求激增、全球芯片周期触底回升影响下，扭转了连续两年的负增长趋势，以最大的波动体现了半导体产业的强周期属性。2024 年消费电子指数 16.19% 的增速与 2023 年 21.04% 的增速相比有所放缓，显示出终端消费的需求疲软。而在原材料价格波动、行业库存调整等因素影响下，电子化学品（-2.34%）成为唯一负增长的指数。



资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

图 14 2024 年电子信息领域各细分赛道指数走势

表 6 我国电子信息领域各细分赛道指数历年回报率

指数名称	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
通信设备	20.47%	-6.91%	6.22%	-18.88%	26.28%	36.32%
电子元器件	59.99%	34.37%	21.23%	-33.10%	4.96%	30.93%
其他电子	52.80%	46.11%	30.22%	-20.92%	3.66%	27.43%
半导体	119.84%	61.29%	33.32%	-37.11%	-5.60%	27.22%
消费电子	93.42%	37.95%	7.56%	-40.44%	21.04%	16.19%
光学光电子	48.88%	13.63%	4.14%	-37.04%	20.35%	5.93%
电子化学品	42.96%	40.71%	19.76%	-24.17%	6.44%	-2.34%

资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

3. 上市企业超过七成盈利，半导体龙头个股市值超万亿

从成分个股的流通市值方面看，我国电子信息领域的行业构成主体为中小型企业，市值百亿元以下的小型企业占比超 62%，市值千亿元以下的中小型企业占比超 97%（见表 7）。总体来看，我国电子信息领域 77.35% 的上市企业处于盈利状态。各细分赛道中，半导体行业的集中度最高，且呈持续提升态势。2024 年新增中芯国际、

海光信息等两家市值超 3000 亿元企业，6 家千亿元以上大型企业的合计市值超 1.44 万亿元，占半导体全行业 159 家企业总市值的比重超 35%。以人工智能芯片为主营业务的寒武纪 2024 年市值增长近四倍，但其经营亏损为 4.47 亿元，虽然与 2023 年同期的 8.76 亿元亏损相比有明显减少，但仍未实现盈利。其在亏损状态下能够实现市值四倍增长，显示出资本市场对其在人工智能芯片领域领先地位的认可，以及对其未来营收预期的高度看好。从行业估值水平分析，市场对特定科技赛道存在非理性估值溢价风险。半导体板块内部分企业估值严重溢价，如帝奥微、格科微、中科飞测等企业 2024 年底的滚动市盈率分别为 7462.65、5271.23、3000.69；此外，光学光电子领域亦存在类似高估值现象，如利亚德、盛洋科技、实益达等企业 2024 年底滚动市盈率超 1000 倍，行业整体估值已偏离历史中枢。

表 7 我国电子信息领域各细分赛道指数成分个股流通市值分布

指数名称	成分个股总计	大型企业		中型企业		小型企业	市盈率 TTM 2024-12-31
		3000-6000 亿元	1000-3000 亿元	500-1000 亿元	100-500 亿元	100 亿元 以下	
半导体	159	2	4	7	75	71	88.57
光学光电子	91	0	1	2	22	66	59.26
消费电子	88	1	3	4	20	60	37.91
通信设备	87	0	2	2	24	59	55.37
电子元器件	55	0	0	5	15	35	29.8
电子化学品	32	0	0	0	9	23	54.09
其他电子	31	0	0	0	6	25	35.26

资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

表 8 我国电子信息领域前 20 成分个股流通市值变化情况

(按最新总市值排序)

成分个股	收盘价(元) 2024-01-01	收盘价(元) 2024-12-31	总市值(亿元) 2024-01-01	总市值(亿元) 2024-12-31	市值变化	市盈率 TTM 2024-12-31	细分领域
工业富联	15.12	21.50	3,003.7153	4,271.6227	42.21%	18.82	消费电子
中芯国际	53.02	94.62	2,121.3904	3,644.6744	71.81%	195.80	半导体
海光信息	70.98	149.79	1,649.8152	3,481.6260	111.03%	184.48	半导体
立讯精密	34.45	40.76	2,466.8550	2,950.1339	19.59%	23.31	消费电子
寒武纪-U	134.96	658.00	562.2359	2,746.8654	388.56%	-358.97	半导体
北方华创	245.71	391.00	1,302.6165	2,084.5052	60.02%	38.06	半导体
中兴通讯	26.48	40.40	1,185.9512	1,797.6839	51.58%	20.58	通信设备
京东方 A	3.90	4.39	1,457.3750	1,639.6512	12.51%	34.18	光学光电子
中际旭创	112.91	123.51	906.4711	1,384.7528	52.76%	29.91	通信设备
韦尔股份	106.71	104.41	1,297.0643	1,269.7546	-2.11%	49.55	半导体
中微公司	153.60	189.16	951.2132	1,177.2632	23.76%	76.49	半导体
蓝思科技	13.20	21.90	657.7861	1,091.2506	65.90%	29.16	消费电子
传音控股	138.40	95.00	1,116.2862	1,083.3330	-2.95%	19.50	消费电子
TCL 科技	4.30	5.03	807.5005	944.5878	16.98%	44.37	光学光电子
歌尔股份	21.01	25.81	718.6267	897.1462	24.84%	35.30	消费电子
鹏鼎控股	22.32	36.48	517.9217	845.8110	63.31%	24.75	电子元器件
新易盛	49.32	115.58	350.1321	819.2387	133.98%	43.01	通信设备
澜起科技	58.76	67.90	669.1238	777.3119	16.17%	65.03	半导体
沪电股份	22.12	39.65	422.1397	760.5410	80.16%	31.59	电子元器件
三环集团	29.45	38.51	564.4085	738.0431	30.76%	36.14	电子元器件

资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

二、风险挑战

（一）资本供给结构变化，早期创新活力受限

2024 年，尽管我国电子信息产业整体投融资规模领跑全行业，但中早期（B 轮及之前）项目数量占比（61.0%）较 2023 年下降超 7 个百分点；且中早期项目的平均融资金额仅为 0.81 亿元，不及成熟项目平均融资金额（6.65 亿元）的八分之一。亿元级及以上项目的

融资金额占总金额的比重连年增加，至 2024 年已增长至 97.0%，头部项目的虹吸效应持续强化，估值膨胀严重挤压中小创新主体生存空间。其中深层次的矛盾在于，宏观经济环境承压背景下，部分投资机构受考核机制限制，更加偏好中后期风险较低、能够更快退出变现的项目。而早期项目融资占比持续走低，短期内将会加剧中小创新主体的融资困境，长期来看或将在技术演进、产业安全和生态创新层面带来系统性连锁风险。

（二）资本退出渠道收窄，压力传至募投环节

随着我国创投市场逐步由快速发展期进入高质量发展期，前期规模快速扩张带来的资本退出压力逐渐显现。据和讯网统计，考虑到往年的投资规模和创投资金 5-7 年的退出周期，2018 年至今有总计超过 6 万亿的创投资金正在或逐渐面临退出问题。这一压力在资本市场深化改革背景下愈发凸显，企业 IPO 上市难度不断加大，资本退出通道逐步收紧，退出周期不断延长，万亿规模的退出“堰塞湖”已然形成。2024 年以来，深创投等国内多家创投机构密集向被投资企业发起诉讼，其中绝大部分都是与被投资企业触发回购条款或对赌协议有关，反映出技术转化周期与资本回报周期的深层冲突。一级市场资本退出周期延长叠加二级市场波动加剧形成双重压力，引发创投生态链的多米诺效应，加速传导至募资端和投资端。在募资端，据投中研究院的统计数据，2024 年我国 PE/VC 市场新成立基金数量接近腰斩，降至近十年谷底。在投资端，清科研究中心数据显示，2024 年我国股权投资市场投资事件数量与金额同比均下降超十

个百分点。资金流动性的降低或将引发创投机构的生存危机，致使资本市场募资融资功能在一定程度上有所减弱，甚至将进一步将金融风险放大传导至实体部门。

（三）估值偏离历史中枢，泡沫存在碎裂风险

当前，我国电子信息领域各细分赛道指数市盈率均处于较高历史分位（见表 9），其他电子、光学光电子、电子化学品等指数的市盈率超 50 倍，半导体指数的市盈率更是接近 90 倍，远远超过全 A 股 15.16 倍市盈率的平均水平，也显著高于美国高成长股指纳斯达克 100 指数 39.60 倍的市盈率。本报告跟踪的 543 只电子信息领域个股中，有 150 只个股的市盈率超 100 倍，21 只个股的市盈率超 1000 倍。反映出资本对技术突破和国产替代进度的过度乐观预期，高估值与盈利增速错配可能引发泡沫碎裂及市场急剧下跌等风险。

表 9 我国电子信息领域各细分赛道指数近五年市盈率 TTM

指数	2020-12	2021-12	2022-12	2023-12	2024-12	历史中枢	2024 偏离度
半导体	96.72	62.52	35.37	68.05	88.57	70.25	26.09%
其他电子	49.92	53.98	23.22	49.37	59.26	47.15	25.68%
光学光电子	54.51	18.76	27.91	70.38	55.37	45.39	22.00%
电子化学品	60.03	66	37.83	55.43	54.09	54.68	-1.07%
电子元器件	45.8	34.86	26.43	32.37	37.91	35.47	6.87%
通信设备	40.48	40.79	25.37	29.78	35.26	34.34	2.69%
消费电子	40.44	39.53	22.9	31.7	29.8	32.88	-9.35%

资料来源：Wind，国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

三、形势研判

（一）技术周期与资本周期共创结构性机遇

当前，电子信息产业正迎来技术迭代与资本流动的周期性同频共振，双重周期叠加将重塑产业竞争格局。技术侧，人工智能领域，

大模型训练效率飞速跃升，工业 AI 质检准确率突破 99.5%，正重塑智能制造的生产范式。5G/6G 通信技术形成代际跨越，时延压缩至 0.1 毫秒量级，催生空天海地一体化网络新场景。存算一体芯片突破冯·诺依曼架构桎梏，能效比提升 10 倍以上，为边缘计算开辟新赛道。量子计算领域，我国超导量子计算原型机“祖冲之三号”实现 105 量子比特操控，计算速度比当前最快的超级计算机快千万亿倍。物联网领域，2024 年我国物联网终端用户数突破 30 亿，加速实现人、机、物泛在连接。

资本侧，全球资本在低利率环境下积极寻找高成长性赛道，美联储降息周期与国内适度宽松的货币政策形成合力，推动中国资产的全球吸引力不断提高。据全球主权财富基金（Global SWF）数据，2024 年中国从各国央行、主权财富基金和公共养老基金管理的基金中吸引了 103 亿美元的投资，与 2023 年的 85 亿美元相比增长 21.18%。从行业分布来看，人工智能、互联网、新能源、电动汽车、高端制造、生物医药是国外主权财富基金在华投资最多的领域。技术与资本的双轮驱动将不断推动我国电子信息产业从“国产替代”向“全球创新策源地”跃迁。

（二）产业政策与金融政策共促高质量发展

在产业政策方面，为贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，充分发挥电子信息产业在工业领域中的支撑、引领和赋能作用，2024 年国家各部门及地方各级政府多措并举，系统推进新型信息基础设施建设、强化核心技术攻关创新、抢占未来产业制高点，

构建全方位政策支撑体系（见附表 1、附表 2）。在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》《关于数字贸易改革创新发展的意见》等政策引导下，形成“基础升级—产业提质—开放突破”的立体化驱动体系，通过设备迭代撬动产能升级、产业链优化保障发展韧性、数字技术赋能全球竞争，系统性推动电子信息产业向高端化、智能化、国际化方向演进。在新型基础设施加速完善、核心技术持续突破、数智化场景深度落地的协同作用下，行业呈现生产稳定增长、投资规模扩大、出口韧性增强的全面发展态势，成为稳增长的关键引擎。根据工业和信息化部公布数据显示，2024 年规模以上电子信息制造业增加值同比增长 11.8%，实现营业收入 16.19 万亿元（+7.3%）、利润总额 6408 亿元（+3.4%）。

在资本市场政策方面，2024 年我国围绕“严监管”与“强支持”双主线推出一系列制度性改革（见附表 3）。一方面，针对上市公司全生命周期强化监管，包括修订检查规定、强化发行准入、压实中介机构责任，并通过退市制度加速市场出清。同时，针对财务造假等问题，提出了多项监管措施，并构建了跨部门追责体系。另一方面，通过结构性工具和创新机制激发市场活力，如推出促进创业投资的政策、拓宽私募基金退出渠道、强化科创板改革等。央行也推出政策增加流动性，支持中长期资金入市。这些政策旨在防范系统性风险，同时促进资本流向新生产力领域。到 2025 年初，已有 20 余项细则落地，形成了全链条监管框架，为资本市场服务现代化产

业体系建设提供了制度保障。

（三）国产替代与出海机遇创造新增量需求

一方面，2024 年国际政治经济环境的不确定性持续增加，半导体、电子设备与元器件等关键技术领域的“卡脖子”问题愈发显现，国产替代已成为保障我国产业链供应链韧性和安全水平的唯一选择，也成为我国电子信息产业发展的重要机遇。5 月，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司正式成立，注册资本高达 3440 亿元人民币，超过前两期总和，宣告我国史上规模最大半导体投资基金的正式落地，标志着我国在半导体产业领域的进一步深入布局。将为半导体行业带来更多的资金投入和研发动力，有助于国内芯片技术的不断突破和发展，芯片代工、高端封装、高频宽记忆体、半导体设备及材料等国内半导体产业链上下游有望迎来新增长机遇。在政策支持、资金投入和技术创新的推动下，我国半导体产业正在加速突破外资技术封锁，国产技术逐步实现对进口产品的替代。摩根士丹利发表的研究报告指出，2024 年中国的半导体自给率为 22%，2026 年将进一步升至 25%。

另一方面，随着我国电子信息产业技术的不断升级和自主品牌的崛起，2024 年我国消费电子企业不断突破从渠道到商标再到品牌的出海，为企业国际传播力的打造奠定了良好基础。尤其是在智能硬件、通信设备、新能源、半导体、汽车等领域，我国企业通过收购、合作、海外建厂等方式，不断加大国际市场的布局，推动品牌全球化，提升国际话语权。安永与中国机电产品进出口商会联合发

布的《中国消费电子和家电行业趋势报告（2024）》指出，中国正成为全球消费电子和家用电器的中心，贡献全球超过 22% 的销售份额。谷歌与凯度公司联合发布的《2024 凯度 BrandZ 中国全球化品牌 50 强》显示，2024 年中国品牌整体实力大幅提升，品牌力增长 17%，创下历年新高；其中，智能设备和汽车品牌表现尤为突出，分别增长 61% 和 51%。根据海关总署数据，2024 年我国电子元件、集成电路、光电技术和汽车等商品的出口金额较上一年度分别增长 6.7%、18.7%、10.8% 和 16.5%。以消费电子为代表的中国出海企业，正将“中国制造”的低成本制造商形象，不断转变为“中国智造”的高端品牌形象。

四、对策建议

（一）进一步优化资本供给结构，激活早期创新生态

一是完善政府引导基金考核体系。增设早期项目投资比例、技术专利转化率等考核指标，推动国有资本向关键核心技术领域的种子期、天使期项目倾斜。二是构建政银担风险共担机制。构建“财政补助+创业投资+科技信贷”风险共担机制，充分发挥政策性融资担保机构融资增信和快速代偿功能，进一步分散降低企业在科技成果转化中的风险。三是完善“产学研融”协同生态。支持高校、科研院所、金融机构联合龙头企业设立产业创新基金，定向孵化硬科技项目，为初创企业提供技术验证、订单导入等配套支持，并通过“分阶段注资+里程碑考核”机制降低早期投资风险。

（二）进一步深化资本市场改革，引导资金接续投入

一是拓宽多元化退出渠道。加快区域性股权市场“专精特新”专板建设，试点私募股权基金份额转让平台与S基金联动机制，支持国有资本以“优先股回购”方式承接私募股权基金份额。二是优化多层次资本市场准入机制。针对关键核心技术领域的硬科技企业设定差异化上市标准，缩短技术转化周期与资本回报周期的错配。三是建立长期资金引入机制。鼓励社保基金、险资等以“母基金+直投”模式参与创投，同时试点“耐心资本”专项计划，对符合国家战略的领域延长投资考核周期，降低短期退出压力。

（三）进一步提升行业企业质量，消化过高估值泡沫

一是强化企业核心竞争力。加大对电子信息产业研发创新的支持力度，瞄准产业链堵点难点卡点，有组织推进战略性、原创性、颠覆性技术攻关，努力实现原始创新重大突破和关键核心技术自主可控。二是完善市场估值约束机制。建立电子信息细分领域动态市盈率预警指标，对偏离度超过阈值的公司强制披露技术商业化进展与盈利改善路径。三是加速行业出清与整合。支持龙头企业开展产业链并购重组，淘汰低效产能，同时严控跨界资本跟风炒作概念，引导资金向优质标的集中，实现估值与业绩的再平衡。

附表 1 2024 年至 2025 年 2 月我国各部门发布电子信息产业相关政策文件

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 1 月	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	工业和信息化部等七部门	从技术创新、产品突破、企业培育、场景开拓、产业竞争力等方面，对未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等 6 大重点方向提出发展目标：到 2025 年，未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展，部分领域达到国际先进水平，产业规模稳步提升；到 2027 年，未来产业综合实力显著提升，部分领域实现全球引领。
2024 年 3 月	《2024 年政府工作报告》	国务院	大力推进现代化产业体系建设，加快发展集成电路、人工智能、高端显示、智能制造等新质生产力，积极培育新兴产业和未来产业，加快推动高水平科技自立自强。
2024 年 3 月	《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》	国务院	围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。
2024 年 7 月	《关于创新信息通信行业管理 优化营商环境的意见》	工业和信息化部	从持续优化高效开放统一的准入环境、积极营造健康公平有序的竞争环境、进一步打造规范透明可预期的监管环境、着力构建便捷可靠优质的服务环境四个方面优化信息通信行业营商环境。
2024 年 7 月	《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》	国家发展改革委、财政部	统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，加力支持新能源公交车、动力电池等设备更新和汽车、家电、废弃电器电子产品等消费品以旧换新。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 8 月	《关于数字贸易改革创新发展的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	支持数字贸易细分领域和经营主体发展,推进数字贸易制度型开放,完善数字贸易治理体系。加强关键核心技术创新,加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。
2024 年 8 月	《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》	工业和信息化部办公厅	夯实物联网底座、提升产业创新能力、深化智能融合应用、营造良好发展环境,系统推进移动物联网应用规模拓展和产业生态繁荣。
2024 年 9 月	《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》	工业和信息化部等十一部门	共同推动新型信息基础设施优化整体布局、完善系统功能、改进发展模式,提升新型信息基础设施系统整体发展水平和服务能力。
2024 年 11 月	《有效降低全社会物流成本行动方案》	中共中央办公厅、国务院办公厅	推动物流数智化发展,提高物流数字化水平,鼓励物流技术攻关,促进大数据、5G、北斗卫星导航系统、物联网等电子信息产业相关技术在物流领域的应用,推动物流装备研发、智慧物流系统集成创新和“人工智能+物流”发展。
2024 年 11 月	《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合,以信息平台建设为牵引,以智能设施建设为基础,以智慧应用场景为依托,推动城市基础设施数字化改造,构建智能高效的新型城市基础设施体系,持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性,推动城市安全发展。
2024 年 12 月	《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	加快推进国家综合交通运输信息平台建设,建立健全全流程数据安全管理制度,加强交通运输系统平台网络安全、数据安全和个人信息保护管理,定期开展安全排查和风险评估,完善交通运输科技资源共享服务体系。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 12 月	《打造“5G+工业互联网”512 工程升级版实施方案》	工业和信息化部办公厅	为推动 5G 与工业互联网融合，实现高质量新型工业化，方案聚焦于提升五大核心能力：网络设施、技术产品、融合应用、产业生态和公共服务。目标是到 2027 年，建设 1 万个 5G 工厂和 20 个以上融合应用试点城市。措施涵盖升级工业网络体系、推广 5G 技术应用、强化技术创新、发展工业终端设备、加速 5G 工厂建设、壮大产业主体、完善公共服务平台等。方案旨在降低综合成本，促进技术融合，提升行业赋能，支持制造和网络强国建设。
2025 年 1 月	《关于推动文化高质量发展的若干经济政策》	国务院办公厅	为深化文化与科技融合，需以机制创新为引领，推动互联网思维和信息科技深度嵌入文化创作生产全流程，实现文化建设的数字化赋能与信息化转型。通过搭建文化数据服务平台等数字化基础设施，构建文化领域人工智能高质量数据集，支持大模型研发应用，系统性提升文化内容生产效能。同时加速文化贸易数字化进程，强化数字文化内容创作与国际传播能力，以数字技术打通文化产业链条，构建从内容生产、数据服务到跨境传播的立体化发展格局。
2025 年 2 月	《2025 年稳外资行动方案》	国务院办公厅、商务部、国家发展改革委	为推进高水平对外开放，需加大引资稳资力度，通过有序扩大自主开放、提升投资促进水平、增强开放平台效能以及加大服务保障力度，构建更具吸引力的投资环境。适时进一步扩大电信等领域的开放试点，为发展新质生产力和实现中国式现代化提供重要支撑，推动经济高质量发展与全球产业链深度融合。

资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

附表 2 2024 年至 2025 年 2 月我国主要省市发布电子信息产业相关政策文件

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 1 月	《关于印发 2024 年北京市高精尖产业发展资金实施指南的通知》	北京市经济和信息化局、北京市财政局	加强电子信息、智能制造等重点领域关键突破，培育特色优势产业集群，提供资金支持。
2024 年 2 月	《关于印发广东省培育发展未来电子信息产业集群行动计划的通知》	广东省工业和信息化厅、广东省发展和改革委员会等	到 2030 年，在未来电子信息产业重点领域关键核心技术上取得突破，未来电子信息企业培育初见成效，未来电子信息产业生态初步搭建，在新一代网络通信、人工智能、虚拟现实、量子信息等领域引领全国，成为未来电子信息培育发展新高地。
2024 年 4 月	《关于印发江苏省机器人产业创新发展行动方案的通知》	江苏省工业和信息化厅、江苏省发展改革委等	推进机器人产业高质量发展，加强创新能力建设，加快关键核心技术攻关，分类培育优质企业。
2024 年 5 月	《浙江信息通信行业现代化发展创新赋能新型工业化实施方案（2024-2027 年）》	浙江省通信管理局	提升区块链、物联网、工业互联网、人工智能等创新能力，持续推进工业领域关键信息通信技术攻关和应用升级，优化升级信息基础设施。
2024 年 6 月	《湖北省信息通信行业 2024 年网络和数据安全“荆楚护航”专项行动方案》	湖北省通信管理局	为提升湖北省信息通信行业网络和数据安全防护水平，筑牢行业安全防线，以高水平安全保障行业高质量发展，湖北省部署开展 2024 年网络和数据安全“荆楚护航”专项行动。该行动旨在全面摸清行业网络和数据资产底数，提升安全防护能力，加强监测处置与应急响应体系建设，同时凝聚多方合力，构建协同高效的网络和数据安全防护体系，为行业发展保驾护航。
2024 年 9 月	《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案	北京市经济和信息化局等四	促进科技成果转化落地，鼓励牵头部署低空经济科技成果孵化器、加速器，孵化转化一批创新成果、产品和

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
	(2024-2027 年)》	部门	技术。加强北斗、5G 等卫星通导遥技术应用,促进商业航天与低空经济融合发展。
2024 年 10 月	《关于印发江西省大力培育电子装备制造产业行动计划(2024-2026 年)的通知》	江西工业和信息化厅	为推动江西省电子装备制造产业高质量发展,增强对电子信息产业的支撑能力,提升产业链供应链韧性、竞争力和安全水平,特制定本行动计划。该计划旨在引导各地积极培育电子装备产业,依托现有基础推进企业集聚,形成产业集群,提升供给能力和水平。到 2026 年,力争新引进上下游企业 30 家,培育营业收入超 10 亿元的电子装备整机制造企业 5 家,打造 3 个特色电子装备制造业试验区,实现全省电子装备制造业营业收入突破 300 亿元。
2024 年 11 月	《北京市关于促进专精特新企业高质量发展的若干措施》	北京市人民政府办公厅	推动大企业联合中小企业深化数智技术应用,围绕人工智能、机器人、商业航天等前沿新兴领域和未来产业方向,引导培育一批专精特新企业。加强产学研用协作,打造未来产业创新联合体,围绕未来产业领域建设一批未来产业育新基地,构建产业链上下游协同创新的生态体系。对参与创新技术应用类场景建设的专精特新企业给予资金支持。
2024 年 12 月	《安徽省新型储能推广应用实施方案》	安徽省工业和信息化厅	在储能领域,电子信息技术的深度应用体现在智能管理与场景创新:针对 5G 基站、大数据中心等高能耗数字基础设施,推动用户侧储能建设,探索微电网、虚拟电厂等新型商业模式;依托智能电网管理系统,通过构网型储能技术优化电力调度,支持源网荷储一体化与多能互补;同时,开发电动汽车双向充放电智能交互技术,强化储能系统与电力市场的数字化协同,提升电网灵活性与能源利用效率,为数字社会构建稳定高效的能源支撑体系。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 12 月	《北京市高精尖产业发展项目资金管理办法》	北京市经济和信息化局、北京市财政局	推动北京国际科技创新中心建设, 深化京津冀协同发展, 持续巩固和提升以科技创新为核心的高精尖产业体系, 增强产业基础能力和产业链现代化水平, 塑造发展新动能新优势, 促进经济高质量发展; 同时, 加强北京市高精尖产业发展项目及资金管理效能, 推进未来产业领域前沿和颠覆性技术攻关应用, 构建未来产业发展生态, 开展新型产业研发机构建设及工程化任务, 推动战略性、公共性关键技术攻关, 提升中试验证和加工服务能力, 加速创新技术产品产业化进程。
2025 年 1 月	《关于印发 2025 年北京市高精尖产业发展项目资金和支持中小企业发展资金实施指南(第一批)的通知》	北京市经济和信息化局、北京市财政局	2025 年北京市高精尖产业发展项目资金和支持中小企业发展资金将重点投向高精尖产业和未来产业, 旨在支持企业调结构强能力, 促进经济平稳增长; 通过提升产业科技创新能力, 培育特色优势产业集群, 推动产业数字化绿色化转型升级, 实现投资提质增效。具体实施方向包括集成电路设计产品首轮流片奖励、机器人创新产品首试首用奖励以及“创赢未来”项目奖励等, 以激发创新活力, 助力产业高质量发展。
2025 年 1 月	《关于下达 2025 年省级制造业当家重点任务保障专项资金(新一代信息技术和产业发展)项目计划的通知》	广东省工业和信息化厅	2025 年省级制造业当家重点任务保障专项资金(新一代信息技术和产业发展)项目计划已下达, 要求各有关单位需增强绩效意识, 加强资金管理监督, 按时完成绩效目标, 做好资金管理、绩效自评及验收考评工作, 切实提升财政资金使用效率。

资料来源: 国家工业信息安全发展研究中心整理 (2025 年 2 月)

附表 3 2024 年至 2025 年 2 月我国资本市场相关政策文件

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 3 月	《首发企业现场检查规定（2024 年修订）》	证监会	强调“申报即担责”，规定在检查过程中对撤回上市申请的企业“一查到底”，撤回上市申请不影响检查工作实施，也不影响依法依规对检查发现的问题进行处理，并增加了不提前告知直接开展检查的机制。
2024 年 3 月	《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》	证监会	着眼于推动上市公司提升投资价值和加强投资者保护，围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题，提出了 4 个方面 18 项政策措施。同时，全面从严加强对企业发行上市活动监管，压紧压实上市公司、中介机构、交易所、证监会派出机构、证监会机关发行监管全链条各相关方责任，维护良好的发行秩序和生态。
2024 年 4 月	《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》	国务院	从总体要求、严把发行上市准入关、严格上市公司持续监管，加大退市监管力度，加强证券基金机构监管，加强交易监管，大力推动中长期资金入市等 9 个方面提出政策部署，是继 2004 年、2014 年两个“国九条”之后，国务院再次出台的资本市场指导性文件。本次新“国九条”主要展现了三大特点：一是资本市场建设重心聚焦在权益市场；二是政策抓手从市场培育转到提升上市公司质量上来；三是特别重视保障中小投资者权益和资本市场投资获得感。
2024 年 4 月	《关于严格执行退市制度的意见》	证监会	进一步严格强制退市标准，逐步拓宽多元化退出渠道，大力削减“壳”资源价值，切实加强监管执法工作，更大力度落实投资者赔偿救济。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 4 月	《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》	证监会	提出引导私募股权创投基金投向科技创新领域。完善私募基金监管办法,丰富产品类型,推动母基金发展,发挥私募股权创投基金促进科技型企业成长作用。落实私募基金“反向挂钩”政策,扩大私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点、份额转让试点,拓宽退出渠道,促进“投资—退出—再投资”良性循环。
2024 年 4 月	《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》	证监会	调降基金股票交易佣金费率;降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限;全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求;明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。
2024 年 5 月	《上市公司股东减持股份管理暂行办法》	证监会	严格规范大股东减持,有效防范绕道减持,三是细化违规责任条款。此外,还强化了上市公司及董事会秘书的义务。
2024 年 6 月	《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》	国务院	围绕“募投管退”全链条优化支持政策,鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资,积极吸引外资创投基金,拓宽退出渠道,完善并购重组、份额转让等政策,营造支持创业投资发展的良好生态。针对创业投资特点实施差异化监管,落细税收优惠政策,支持专业性机构发展,处理好政府性基金和市场化基金关系,充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。
2024 年 6 月	《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》	证监会	“科创板八条”进一步强化了科创板“硬科技”的定位,同时完善了发行上市、再融资、并购重组、股权激励、交易机制等方面的制度措施,增强对“硬科技”企业包容性的同时加强对科创板上市公司的全链条监管,为科技企业打造一个更为良好的投融资环境。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 7 月	《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》	证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委	坚决打击和遏制重点领域财务造假，优化证券监管执法体制机制，加大全方位立体化追责力度，加强部际协调和央地协同，常态化长效化防治财务造假。打防并举、标本兼治，深化公司治理，压实中介机构责任，增加基础制度供给，从源头防范造假发生。
2024 年 9 月	“924”一揽子增量金融政策	人民银行、金融监管总局、证监会	资本市场方面，一是创设新的货币政策工具，包括创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押，从中央银行获取流动性，首期互换便利操作规模 5000 亿元，未来可视情况扩大规模。同时创设股票回购增持专项再贷款，首期规模 3000 亿元；二是研究设立平准基金；三是推动中长期资金入市，包括大力发展权益类公募基金、完善“长钱长投”的制度环境、持续改善资本市场生态等；四是支持并购；五是指引上市公司依法做好市值管理。
2024 年 9 月	《关于推动中长期资金入市的指导意见》	中央金融办、证监会	建设培育鼓励长期投资的资本市场生态，大力发展权益类公募基金，支持私募证券投资基金稳健发展，着力完善各类中长期资金入市配套政策制度。
2024 年 9 月	《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》	中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、农业农村部、商务部、中国人民银行、金融监管总局	深化资本市场领域衍生品监管改革。完善资本市场领域衍生品监管规则，统一对证券期货经营机构开展衍生品交易的监管尺度和强度。健全资本市场领域交易报告库，建立统一规范的机构、产品、交易识别体系，提高数据质量和可用性，推进报告库间数据互通，为强化系统性风险监测监控提供支撑。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024年11月	《上市公司监管指引第10号——市值管理》	证监会	为贯彻落实国务院关于加强资本市场高质量发展的部署，引导上市公司提升投资价值与投资者回报，证监会发布并实施《指引》，以增强公司质量为核心，要求企业通过优化经营效率、合规运用并购重组、股权激励、现金分红等多元化手段合理反映内在价值，并明确董事会及高管责任，特别规定主要指数成份股公司需制定市值管理制度、长期破净企业须披露估值提升计划，同时严禁以市值管理名义实施违法违规行为。
2024年12月	《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》	国资委	推动中央企业高度重视控股上市公司的市场价值表现，切实维护投资者权益，促进资本市场健康稳定发展，规范开展市值管理工作；着力提高上市公司发展质量，通过开展有利于提升投资价值的并购重组、加大市场化改革力度、全面提高信息披露质量、主动加强投资者关系管理等措施，稳定投资者回报预期，完善增强投资者信心的制度安排，健全市值管理工作制度机制，并严守依法合规底线，确保市场运作规范有序。
2024年12月	《中国证监会发布《期货经纪合同要素》等5项金融行业标准》	证监会	修订《期货经纪合同要素》，细化期货交易责任分配、风险控制等条款以保障投资者权益；制定《证券期货业信息系统备份能力规范》，明确数据备份与容灾能力指标，强化行业网络安全韧性；推出《期货公司逻辑模型》标准，推动数据标准化处理与集中管理；发布《区域性股权市场分布式数字身份技术规范》，构建跨域身份认证与可信数据流通体系；统一企业、产品和投资者编码规则，促进市场规范管理 with 投融资对接。

发布时间	文件名称	发布单位	主要内容
2024 年 12 月	《关于进一步完善个人转让上市公司限售股所得个人所得税有关征管服务事项的公告》	国家税务总局、财政部、证监会	税务总局、财政部、中国证监会在充分研究论证基础上，优化调整个人转让上市公司限售股所得个人所得税纳税地点，通过税收大数据实现“全国通办”，在不增加纳税人、扣缴义务人办税负担基础上，促进税源地与税收入库地更好匹配，提高纳税服务水平，促进限售股减持更加规范，助力资本市场健康稳定发展。
2024 年 12 月	《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》	最高人民法院、证监会	该文件强调“积极拯救与及时出清”原则，要求严格筛选具备重整价值的上市公司，对存在重大违法退市风险、拒不整改或违规占用资金的企业不予支持；明确建立司法与监管重大事项通报及会商机制，强化重整计划合规性（如资本公积金转增比例、股份锁定期等须符合证监会规定），压实信息披露主体责任，完善内幕交易防控措施，并细化重整案件管辖标准及执行要求，以保障债权人、中小投资者合法权益，促进上市公司质量提升与资本市场健康发展。
2025 年 1 月	《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》	国务院办公厅	完善多层次资本市场体系，提高新三板和区域性股权市场服务股权投资的能力，拓宽政府投资基金退出渠道。
2025 年 1 月	《关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》	国务院	为了规范中介机构为公司公开发行股票提供服务行为，特制定关于提高上市公司质量，保护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展的规定。该规定已于 2025 年 2 月 15 日起开始施行。

资料来源：国家工业信息安全发展研究中心整理（2025 年 2 月）

参考文献

- [1] 清科研究中心.2024 年中国股权投资市场研究报告.<https://report.peidata.cn/1700098909911123.html>.2025 年 1 月.
- [2] 投中研究院.投中统计：2024 年募资市场降至冰点 头部机构出资减少 54%.<https://www.chinaventure.com.cn/report/1005-20250115-1792.html>.2025 年 1 月.
- [3] 工业和信息化部.2024 年我国规上电子信息制造业增加值同比增长 11.8%.https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202502/content_7002566.htm.2025 年 2 月.
- [4] 安永.中国消费电子和家电行业趋势报告（2024）.<https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/zh-cn/insights/consumer-products/documents/ey-market-trends-report-2024-zh.pdf>.2024 年 2 月.
- [5] 凯度 KANTAR.2024 凯度 BrandZ 中国全球化品牌 50 强.https://mp.weixin.qq.com/s/iiD45_qmzun87GU9jjXsRg.2024 年 6 月.
- [6] 和迅.6 万亿创投资金的退出之困.<https://mp.weixin.qq.com/s/ipdy4Utz2S-E7PQgJYsNjw>.2024 年 8 月.
- [7] crunchbase.Startup Funding Regained Its Footing In 2024 As AI Became The Star Of The Show.<https://news.crunchbase.com/venture/global-funding-data-analysis-ai-eoy-2024/>.2025 年 1 月.
- [8] Global SWF.<https://globalswf.com/>.2025 年 1 月.

2025 年“工信安全智库”系列研究报告

报告编号	报告名称	发布时间
2025-dc-01	世界主要国家商业航天竞争态势及我国面临挑战	2025 年 1 月
2025-dc-02	2024-2025 年度我国电子信息产业投融资情况分析	2025 年 2 月

本报告版权属于国家工业信息安全发展研究中心，转载、摘编、引用本报告文字、数据或者观点的，应注明来源。

联系人：王蕊 18612983082